【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和6年11月6日(2024.11.6)

【公開番号】特開2023-81264(P2023-81264A)
【公開日】令和5年6月9日(2023.6.9)
【年通号数】公開公報(特許)2023-107
【出願番号】特願2022-74110(P2022-74110)
【国際特許分類】
Ｈ０５Ｋ　3/00(2006.01)
Ｈ０５Ｋ　3/46(2006.01)
Ｈ０５Ｋ　1/11(2006.01)
Ｈ０５Ｋ　3/40(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０５Ｋ　3/00　　Ｎ
Ｈ０５Ｋ　3/46　　Ｂ
Ｈ０５Ｋ　3/46　　Ｖ
Ｈ０５Ｋ　3/46　　Ｋ
Ｈ０５Ｋ　1/11　　Ｈ
Ｈ０５Ｋ　3/40　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】令和6年10月25日(2024.10.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１面及び第２面を有するガラス基板の前記第１面に第１配線層が形成されており、
前記第２面にガラスで構成される剥離除去可能な第１支持体が接着されており、
前記ガラス基板及び第１支持体の双方にレーザ照射による改質部が形成されており、
前記ガラス基板にエッチング処理により貫通孔を形成することが可能な多層配線基板。
【請求項２】
請求項１に記載の多層配線基板において、
前記第１配線層の上方に、剥離除去可能な第２支持体が接着されている
ことを特徴とする多層配線基板。
【請求項３】
請求項２に記載の多層配線基板において、
前記第１支持体が剥離除去されており、前記ガラス基板の前記第２面にはレーザ照射による改質部が表出している
ことを特徴とする多層配線基板。
【請求項４】
請求項３に記載の多層配線基板において、
前記ガラス基板にエッチング処理により貫通孔が形成されている
ことを特徴とする多層配線基板。
【請求項５】
請求項４記載の多層配線基板において、
前記ガラス基板の前記第２面には第２配線層が設けられており、

前記第２配線層の一部は、前記貫通孔の側面に形成された貫通電極と接続されている
ことを特徴とする多層配線基板。
【請求項６】
請求項５に記載の多層配線基板において、
前記第２配線層および前記貫通電極の少なくとも一層以上は、耐フッ酸金属と異なる金属材料で形成されていることを特徴とする多層配線基板。
【請求項７】
請求項５又は６に記載の多層配線基板において、
前記第２支持体が剥離除去されており、前記第１配線層の上方及び前記第２配線層の下方にそれぞれビルドアップ層が形成可能である
ことを特徴とする多層配線基板。